

证券代码：002156

证券简称：通富微电

通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参与公司 2022 年度业绩网上说明会的投资者
时间	2023 年 4 月 12 日 15:00-17:00
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ http://rs.p5w.net ）
上市公司接待人员姓名	公司董事长石明达先生、董事副总经理夏鑫先生、独立董事袁学礼先生、副总经理兼董事会秘书蒋澍先生、财务总监朱红超先生、保荐代表人程韬先生。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的主要问题进行了答复:</p> <p>问题一: 请问领导, 公司近期是否有增持回购注销股份计划?</p> <p>答: 尊敬的投资者, 您好! 如后续有增持回购注销股份计划, 公司将及时披露相关公告, 您可以关注公司相关动态。谢谢!</p> <p>问题二: 您好, 根据公司的业内观察, 现在封测行业处于周期的哪个位置? 谢谢。</p> <p>答: 尊敬的投资者, 您好! 2022 年, 受欧洲政治风险升级、美国持续高通胀等外部因素影响, 全球经济面临巨大挑战, 导致集成电路行业景气度下降, 2022 年第二季度开始集成电路销售额增速逐季下滑。随着全球经济回暖, AI、数据中心、5G、智能汽车等新兴应用端需求持续发展,</p>

2023 年集成电路产业有望触底并逐渐复苏。谢谢！

问题三：公司有什么技术优势吗？

答：作为国家高新技术企业，公司先后承担了多项国家级技术改造、科技攻关项目，并取得了丰硕的技术创新成果：自建 2.5D/3D 产线全线通线，1+4 产品及 4 层/8 层堆叠产品研发稳步推进；基于 Chip Last 工艺的 Fan-out 技术，实现 5 层 RDL 超大尺寸封装（65×65mm）；超大多芯片 FCBGA MCM 技术，实现最高 13 颗芯片集成及 100×100mm 以上超大封装。

公司在发展过程中不断加强自主创新，并在多个先进封装技术领域积极开展国内外专利布局。截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计国内外专利申请达 1,383 件，其中发明专利占比约 70%；同时，公司先后从富士通、卡西欧、AMD 获得技术许可，使公司快速切入高端封测领域，为公司进一步向高阶封测迈进，奠定坚实的技术基础。

问题四：对于 chiplet 技术，公司现在有投产吗？

答：公司在先进封装方面已大规模生产 Chiplet 产品，7nm 产品已大规模量产，5nm 产品已完成研发并逐步量产。谢谢。

问题五：公司 2022 年营收增幅达 35%，但归母净利润却同比减少，是什么原因？

答：2022 年，是公司充满挑战和变化的一年，在挑战中奋进，在变局中蜕变，在不确定的世界努力构建属于公司的确定性，共同迎接“百年未有之大变局”新时代的新挑战。

2022 年，公司积极调整产品业务结构，加大市场调研与开拓力度，持续服务好大客户，凭借 7nm、5nm、FCBGA、Chiplet 等先进技术优势，不断强化与 AMD 等行业领先企

业的深度合作，巩固和扩大先进产品市占率。

2022年，公司实现营业收入214.29亿元，同比增长35.52%，在全球前十大封测企业中，公司营收增速连续3年保持第一，公司实现归属于母公司股东的净利润5.02亿元，同比下降47.53%。受汇率波动影响，公司产生汇兑损失，因此减少归属于母公司股东的净利润2.11亿元。如剔除该非经营性因素的影响，公司归属于母公司股东的净利润应该为7.13亿元，同比下降25.46%；另外，由于集成电路行业景气度下行，部分终端产品需求疲软，导致公司产能利用率及毛利率下降；公司加大Chiplet等先进封装技术创新研发投入，研发费用增加，导致利润下降。谢谢！

问题六：2022年，在封测行业占比多少，跟上年比较，增幅多少？

答：根据芯思想研究院的排名，公司2022年在全球的市占率为6.51%，较2021年的5.51%，增长1个百分点。谢谢！

问题七：能展望一下今年境内的营收增长的预期在哪些方面吗？

答：新增产能承接的订单主要来自于：高性能计算、服务器、新能源、电源管理、汽车电子、显示驱动、存储、MCU。谢谢！

问题八：公司最近高管有增持计划吗？

答：如后续有明确的高管增持计划，公司将及时披露相关公告，您可以关注公司相关动态。谢谢！

问题九：目前chiplet在营收中占比多少，预计2023年能占多少？

答：公司构建了国内最完善的 Chiplet 封装解决方案，为客户提供多样化的产品服务，助力客户突破技术瓶颈，有望获得更多市场份额，进而形成公司差异化竞争优势。

问题十：公司债务规模增加很快，抗风险能力怎么样？增收不增利如何解决？

答：集成电路机会很多，加大投资，债务规模有所增加，目前公司资产负债率 59.13%，风险相对可控。加大市场开拓，优化产品结构，进一步提高产能利用率，增强盈利水平。谢谢！

问题十一：能简要介绍一下目前公司产能利用率和在手订单的情况吗？

答：谢谢您的提问，随着中国经济复苏，消费市场信心的提升，外部经济环境逐步向好，会给企业经营带来利好。

问题十二：公司增收不增利，与同行差距较大（特别是长电），有什么举措？

答：公司的产品结构及客户结构与友商存在较大差别。我们将从稳固国际客户基本盘，提升国内头部客户份额；通过优势产品和传统产品相结合，合理分配资源，确保利益最大化；以及优化产品方案，提升服务品质等方面，进一步提升公司盈利能力。谢谢！

问题十三：石明达董事长 有没有收购公司的企业或者是出售公司的部分股权？

答：公司专注专业于半导体封测行业。在半导体周期下行区间，是开展兼重组、扩大规模的好机会。全体经营层始终把通富的事业做强做大，作为自己的使命任务。我们会持续关注产业并购、整合机会，审慎决策相关投资行为，谢谢你的关注。

问题十四：石董您好，公司占 AMD 封测订单 80%，如何防范后续 AMD 将通富订单转移给其它供应商风险？

答：公司通过“合资+合作”的方式，与国际大客户建立了稳定的战略合作伙伴关系，在品质、交货期、研发等方面得到了客户的高度认可，签订了长期业务协议，不存在解除合作的风险。谢谢！

问题十五：公司和 AMD 是合作还是合资公司，现在大国博弈不平静，对通富的影响如何？

答：尊敬的投资者，您好！我们与 AMD 成立了合资公司。目前，公司与 AMD 的合作没有受到影响。对公司而言，在目前的国际大环境下，更需要加强国际化合作，以加快项目建设来实现国产替代，以加大研发投入来提升创新能力。谢谢！

问题十六：能否介绍一下 chiplet 方面的工作开展吗？

答：谢谢您的关注！公司通过在多芯片组件、集成扇出封装、2.5D/3D 等先进封装技术方面的提前布局，可为客户提供多样化的 Chiplet 封装解决方案，并已量产，形成了差异化竞争优势。

问题十七：请问公司领导，公司在 2020 年度国家科学技术奖励大会上荣获国家科技进步一等奖。这是很重要的核心竞争力的体现。请问 2024 年在国家级和省一级的报奖项目中有什么储备吗？

答：你说的很对，公司要获得长远发展，加大技术研发力度，全面提升核心竞争力，贯彻落实科技自立自强战略。公司会持续做好“卡脖子”技术研发工作，积极申报国家级、省级科技技术项目。谢谢。

问题十八:公司持续大额投资紧追国产化浪潮,是否过于冒进?你怎么看?

答:感谢您的关注!公司不忘初心,产业报国,希望在实干兴邦的道路上砥砺前行,取得突破。没有哪一项投资没有风险,但要增强企业实力,短时间内实现弯道超车,就得有阔步向前的勇气和决心。当然,实际投资时,我们也会做好各项分析,审慎决策。

问题十九:能谈谈贵公司的愿景吗?

答:公司专注于集成电路封测,努力提升产品的设计研发、品质控制、市场营销、资源整合等四种核心能力,逐步靠实力、业绩、贡献树立起“通富微电”品牌。未来将进入一个胜者为王的时代,我们的目标是,强基固本、灵活应变。只有强大且稳定的基本盘,才能保证我们拥有足够的灵活度,去积极应对剧烈变化市场竞争环境,促使我们始终强劲的市场竞争力。围绕上述目标,公司制定了四大发展战略:1、巩固和发展海外客户;2、全力提升国内市场地位;3、大力发展海外基地建设;4、构建创新生态,关注产投结合。基于四大战略,积极推动四大“提升年”活动:2023年,是通富“客户满意度提升年”,是“提质降本效益提升年”,是“产品竞争力提升年”,是“体系化、集团化管理提升年”。未来,我们希望成为封测行业的标杆,在核心竞争力、风险管控能力、信息化管理水平、国际知名品牌等方面实现国际先进,实现组织的基业长青,永续经营。感谢您的关注!

问题二十:你好请问今年受市场影响,业绩与去年相比能有提升吗?

答:公司2023年营收目标是248亿,同比增幅15%以上。

问题二十一:美国AMDzen5即将发布,请问公司是否具备

zen5 封测技术，能否抢到订单？

答：尊敬的投资者，您好！公司将全力配合国际大客户产品的更新迭代，已具备 zen5 相关封测技术，相关产品正在验证生产过程中。谢谢！

问题二十二：请问一下，大客户依赖会不会给公司未来发展带来很大不确定性？

答：尊敬的投资者，您好！一方面，公司国际大客户发展势头强劲，目前看，公司与其业务具有可持续性；另一方面，公司积极开拓、发展其他第三方客户，进一步加强公司客户多元化。截至目前，大多数世界前 20 强半导体企业和绝大多数国内知名集成电路设计公司都已成为公司客户。谢谢！

问题二十三：国内新增产能承接的订单主要来自哪些行业？是否有来自新能源汽车行业芯片封测订单？新增订单的利润率相较于传统的业务如何？

答：新增产能承接的订单主要来自于：高性能计算、服务器、新能源、电源管理、汽车电子、显示驱动、存储、MCU。有来自新能源汽车行业芯片封测订单，新增订单的利润率相较于传统的业务高一些。谢谢！

问题二十四：半导体人才紧缺，公司如何留住人才？

答：尊敬的投资者，您好！人才的需求和培养对一个快速发展的公司来说永远是个挑战，公司已推出员工持股计划、股权激励等措施，通过引进和自己培养的人才基本满足公司当下发展的需求。谢谢！

问题二十五：chatgpt 的诞生对公司长远发展有没有积极影响。

答：如 Chatgpt 大爆发，应该会拉动集成电路相关产品的

需求。公司向来重视发展先进封测技术和产品，我们将积极关注产业、市场、客户、技术等方面的变化，抓住机遇，为股东创造价值。

问题二十六：公司 22 年研发费用支出大幅增加的原因和必要性？未来几年该费用的预估多少？

答：公司 2022 年主要在 Chiplet 制程等加大研发投入，2022 年研发费用大幅增加；随着 7nm、5nm、3nm 等先进制程的迭代，研发投入将持续增加。

问题二十七：贵司没有做市值的想法吗？

答：公司专注于封装测试主业，希望通过主业市场份额的提升，带动市值的增长，谢谢。

问题二十八：公司还有进行股权激励的计划吗？

答：如后续有明确的股权激励实施计划，公司将及时披露相关公告，您可以关注公司相关动态。未来，公司会继续健全公司长效激励约束机制，以进一步增强公司核心人才团队的稳定性和工作积极性。感谢您的关注！

问题二十九：公司有 cpo 技术储备吗

答：你好，公司 CPO 项目正处于前期技术调研阶段。感谢对通富的关注，谢谢。

问题三十：公司 2023 年有什么投资计划？

答：公司及下属控制企业南通通富、合肥通富、通富通科、通富超威苏州及通富超威槟城等计划 2023 年在设施建设、生产设备、IT、技术研发等方面投资共计 42 亿元。感谢您的关注！

问题三十一：最近成立的公司，是有电路板设计，请问有

芯片设计吗？有芯片制造的那个环节？

答：新公司主要从事集成电路封装测试业务，谢谢。

问题三十二：请问一下：今年能有在建工程投产贡献业绩吗？占比多少？

答：将会产生部分业绩，谢谢。

问题三十三：有券商研报提到公司发展空间巨大，认为公司未来市值可达千亿，请问公司如何看这个预测？

答：二级市场股价受全球经济环境、大盘走势、行业景气度、市场情绪、投资者心理、公司基本面等诸多因素影响，具有波动性。我们将持续做好生产经营工作，以回馈股东对公司的信任。

问题三十四：公司本次利润分配预案每 10 股分配金额较 20 年翻了好几倍，是什么原因？

答：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《股东回报规划》等相关规定，在满足现金分红条件时，公司三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

2021 年为不影响非公开发行工作的实施进度，从股东利益和公司发展等综合因素考虑，公司 2021 年度未进行利润分配，也未进行资本公积转增股本。公司已在 2022 年 11 月 14 日完成本次非公开发行，结合公司目前经营状况，为积极回报股东，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出 2022 年度利润分配预案，每 10 股派发现金红利 0.97 元(含税)。

问题三十五：您好，请问和 AMD 的合作有受到中美政治关系的影响吗？

答：目前不受影响，感谢您的关注！

问题三十六：请问下半年公司销售增长但是利润率下降的原因？

答：下半年受集成电路市场周期影响，部分终端产品需求疲软，产品结构变化，营收虽有增长，但毛利率下降。谢谢！

问题三十七：请问公司有涉及人工智能相关芯片的封测吗？

答：尊敬的投资者，感谢您的关注！如人工智能应用大爆发，应该会拉动集成电路相关产品的需求，公司向来重视发展先进封测技术和产品，已具备封测 CPU、GPU、服务器等高端产品的能力。

问题三十八：公司是否实现国产替代，自主可控？

答：尊敬的投资者，您好！作为中国大陆排名第二的封测企业，公司时刻关注自主可控、国产替代的政策及趋势，从中抓住机会，为股东创造价值。感谢您的关注！

问题三十九：石总，您好，想了解下公司未来两年的资本支出计划以及公司在设备国产化替代方面的规划是怎么样的，现在封装设备的国产化率是多少？

答：在设备性能基本相同的情况下，公司会加大国产设备的采购力度。谢谢。

问题四十：领导，您好！我来自大决策，请问在美日荷联手限制我芯片的情况下，作为先进封装的龙头企业，公司会在芯片领域加大投入吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司作为全球第四大封测企业，一直关注全球及中国集成电路产业链的变化，我们将继续

专注封测主业，根据市场需求及产业链变化趋势，进行相关投入。谢谢！

问题四十一：石董您好，近期看到有媒体说，封测作业半导体产业链偏后端，周期下降的影响可能刚刚开始，今年封测行业业绩会更加承压，是不是？谢谢。

答：公司 2023 年生产经营“挑战与机遇”并存，挑战是公司可能会面临行业触底过程中的阵痛，机遇是行业新技术（Chiplet 等先进封装新技术）、新应用（ChatGPT 等人工智能新应用）带来的广阔发展空间。另外，从技术角度看，先进封装技术成为延续摩尔定律的最佳选择之一，我们认为先进封装技术今后在产业链中的作用将更为突出。感谢您的关注！

问题四十二：石董您好，关于 2022 年利润下降的事宜，公司和长电的外销占比结构差异不大，且宏观行业环境一样，那为什么相对于长电的 2022 年利润增长，公司的利润是下降的？有没有其它原因？谢谢！

答：（1）公司产品结构、客户结构与长电存在着差异，不能简单相比。（2）公司营收增长快，2022 年公司实现营业收入 214.29 亿元，同比增长 35.52%，在全球前十大封测企业中，公司营收增速连续 3 年保持第一，相应的资本性投入比较大，折旧政策比较激进，折旧占营收比较高。另外，相应银行融资规模加大，利息支出增加。（3）因汇率波动，公司汇兑损失增加。（4）因美联储加息，美元贷款利息增加，增加财务费用。（5）公司加大 Chiplet 等先进封装技术创新研发投入，研发费用增加。以上因素导致利润下降。

问题四十三：尊敬的董秘你好，请问贵司是否获得阿里版 GPT 通义千问的资格？

答：尊敬的投资者，感谢您的关注！如通义千问等人工智能应用大爆发，应该会拉动集成电路相关产品的需求，公司向来重视发展先进封测技术和产品，已具备封测 CPU、GPU、服务器等高端产品的能力。

问题四十四：2023 年第一季度公司经营情况如何，封测行业是否有起稳回升的迹象？谢谢！

答：尊敬的投资者，你好！公司 2023 年第一季度经营情况，敬请关注将于 4 月底披露的一季报。谢谢！

问题四十五：1、库存及应收等减值情况如何？

2、营收主要来自海外的马来西亚工厂，2023 年国内市场如何拓展？单一需方如何规避风险？

3、人员结构专科及高中生占比极大，既然不需要这么多高学历人员，是否有考虑智能工厂规划，优化人员结构，降低人工成本？

答：1、具体详见公司 2022 年年报。2、（1）公司营收 70% 左右来自海外市场，马来西亚工厂收入只占了境外收入近一半。（2）随着国内市场需要扩大，公司积极开发国内客户，2022 年境内营收较去年同期增长 18.5%，国内市场拓展良好。（3）单一需方为公司战略客户，其自身发展态势良好，在全球市场有很强的竞争力，为公司的发展作出了较大的贡献，未来还会延续；同时公司借助高端产品制造平台，积极拓展国内外客户，规避此类风险。3、（1）智能化工厂适合产品单一大批量生产的产品，而公司多为 OSAT 客户，订单存在多批次小批量的情况，需要人工干预切换，符合封测业用工的基本特点。（2）公司也正在做一些智能化工厂的改造，将简单的、重复性高的、人员密集的岗位进行优化改造，减少用人，降低人工成本。

问题四十六：尊敬的董秘你好，请问贵司有为客户提供高

	<p>算力芯片封装服务吗？</p> <p>答：公司可以为客户提供 CPU、GPU、服务器等高端产品的封测服务。谢谢！</p> <p>（公司 2022 年度业绩网上说明会全部内容可在全景网（http://ir.p5w.net）进行查阅。）</p>
附件清单(如有)	无
日期	2023 年 4 月 12 日